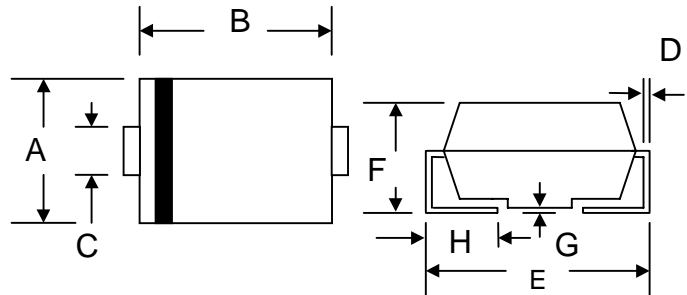


主要电气参数

I _{F(AV)}	1.0A
V _{RRM}	50 - 1000V
I _{FSM}	30A
I _R	5 μ A
V _F	1.0 - 1.3V
T _{j max}	150 $^{\circ}$ C
T _{rr}	150-400ns

封装尺寸规格:



特性:

- 高性能快恢复 GPP 芯片
- 外壳塑封体通过 UL 认证, 阻燃性等级为 94V-0
- 专为 SMT 自动贴片设计
- 具有适合高频线路应用的快速反向电流恢复时间
- 低正向压降, 低反向漏电损耗
- 耐瞬间高正向浪涌电流冲击
- 耐高温焊接: 引脚焊接温度 250 $^{\circ}$ C/10s
- 高可靠性要求

SMA/DO-214AC		
Dim	Min	Max
A	2.50	2.90
B	4.00	4.60
C	1.40	1.60
D	0.152	0.305
E	4.80	5.28
F	2.00	2.44
G	0.051	0.203
H	0.76	1.52
All Dimensions in mm		

外观参数:

- 封装: 符合 JEDEC DO-214AC 标准
- 引脚: 表面镀锡, 可焊性参照 MIL-STD-750, Method 2026
- 极性标示: 激光打印, 阴极标有阴极线条

额定参数表:

如无特殊说明, 参考温度均为 T_c = 25 $^{\circ}$ C

电气参数	符号	RS1A	RS1B	RS1C	RS1D	RS1E	RS1G	RS1J	RS1K	RS1M	单位
交流最高反向峰值电压	V _{RRM}	50	100	150	200	300	400	600	800	1000	Volts
交流最高反向电压有效值	V _{RMS}	35	70	105	140	210	280	420	560	700	Volts
直流最高反向截止电压	V _{DC}	50	100	150	200	300	400	600	800	1000	Volts
最大平均正向整流电流 @ T _L =100 $^{\circ}$ C	I _F	1.0									Amps
交流单相, 半波8.3ms正向浪涌电流, 负载参考上述负载(JEDEC标准)	I _{FSM}	30.0									Amps
最高正向电压 @ 2.0A直流电流	V _F	1.30									Volts
最高直流反向漏电流@直流最高反向截止电压	IR	25 $^{\circ}$ C	5.0								uAmps
		125 $^{\circ}$ C	100.0								uAmps
最大热阻(注1)	R θ JA	55.0									$^{\circ}$ C/W
	R θ JL	18.0									
反向电流恢复时间	T _{RR}	150						250	400		nSec
结电容(注2)	C _j	50									pF
工作结温和储存温度范围	T _J , T _{STG}	-55 to 150									$^{\circ}$ C

注1: 热阻测试时将本产品贴装在0.4" X 0.4"(10.0mm X 10.0mm)的P.C.B上, 且焊盘材料为铜质焊盘
 注2: 在4.0V, 1MHz条件下测试结电容

典型特性曲线图: 如无特殊说明, 参考温度均为 $T_c = 25\text{ }^\circ\text{C}$

FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

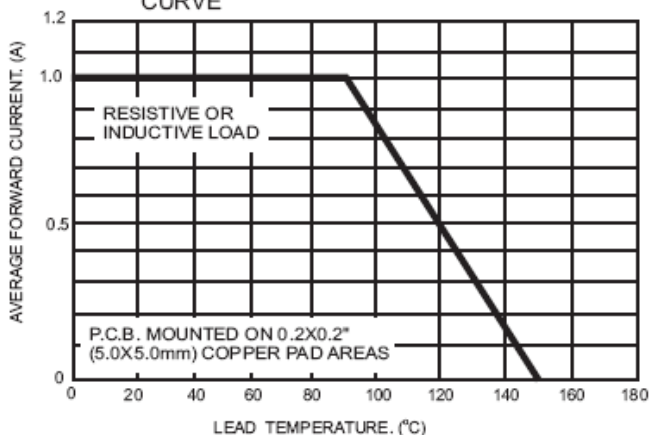


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

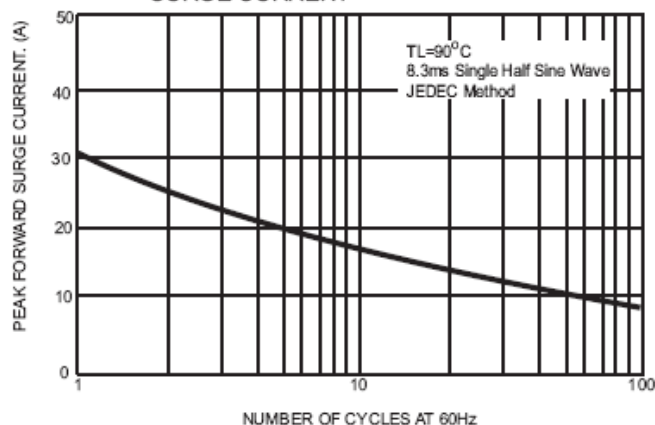


FIG.3- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

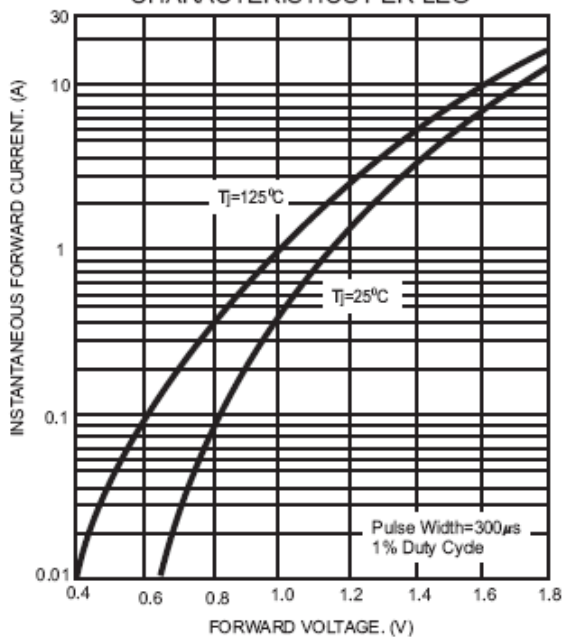


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

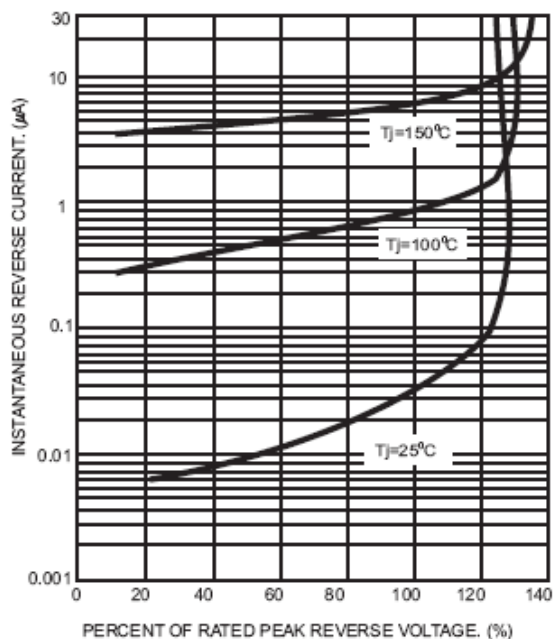


FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

